



# 2013年3月期 第3四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2013年2月8日

代表取締役社長 赤尾 泰

# エグゼクティブサマリ

## I. 2013年3月期 第3四半期 決算概要

- 世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の顕在化などにより、半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円
- 営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字

## II. 2013年3月期 通期業績予想

- 上記の中国向け需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞に伴う需要減などにより、売上高、損益とも前回予想(12月10日公表)から下方修正

## III. 人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況

- 費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進
- 国内後工程の3工場売却について1月30日に基本合意するなど、生産構造対策は着実に進展

# I. 2013年3月期 第3四半期 決算概要

# 2013年3月期 第3四半期 決算概要

- 半導体売上高は、世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の顕在化などにより、前四半期比14%減の1,772億円
- 営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字

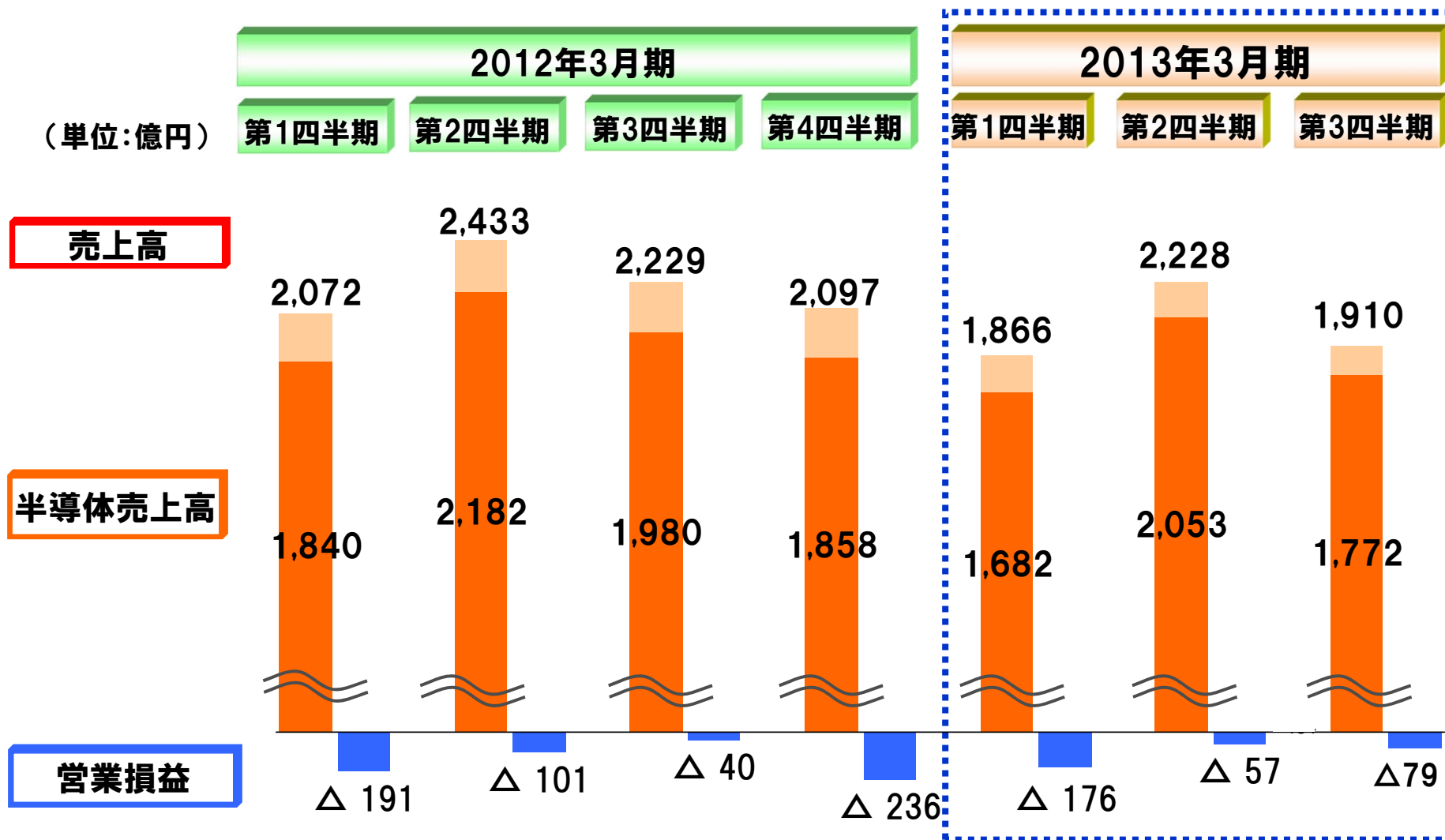
2012年3月期

2013年3月期

(単位:億円)

	第3四半期	第2四半期	第3四半期	前四半期比	前年同期比
<b>売上高</b>	2,229	2,228	1,910	△318 (△14%)	△318 (△14%)
<b>半導体売上高</b>	1,980	2,053	1,772	△281 (△14%)	△208 (△11%)
<b>営業損益</b>	△40	△57	△79	△22	△40
<b>経常損益</b>	△36	△68	△111	△43	△75
<b>四半期純損益</b>	△24	△943	△466	+477	△442
1US\$=	77円	79円	79円	±0円	2円 円安
1ユーロ=	105円	98円	102円	4円 円安	3円 円高

# 四半期業績推移

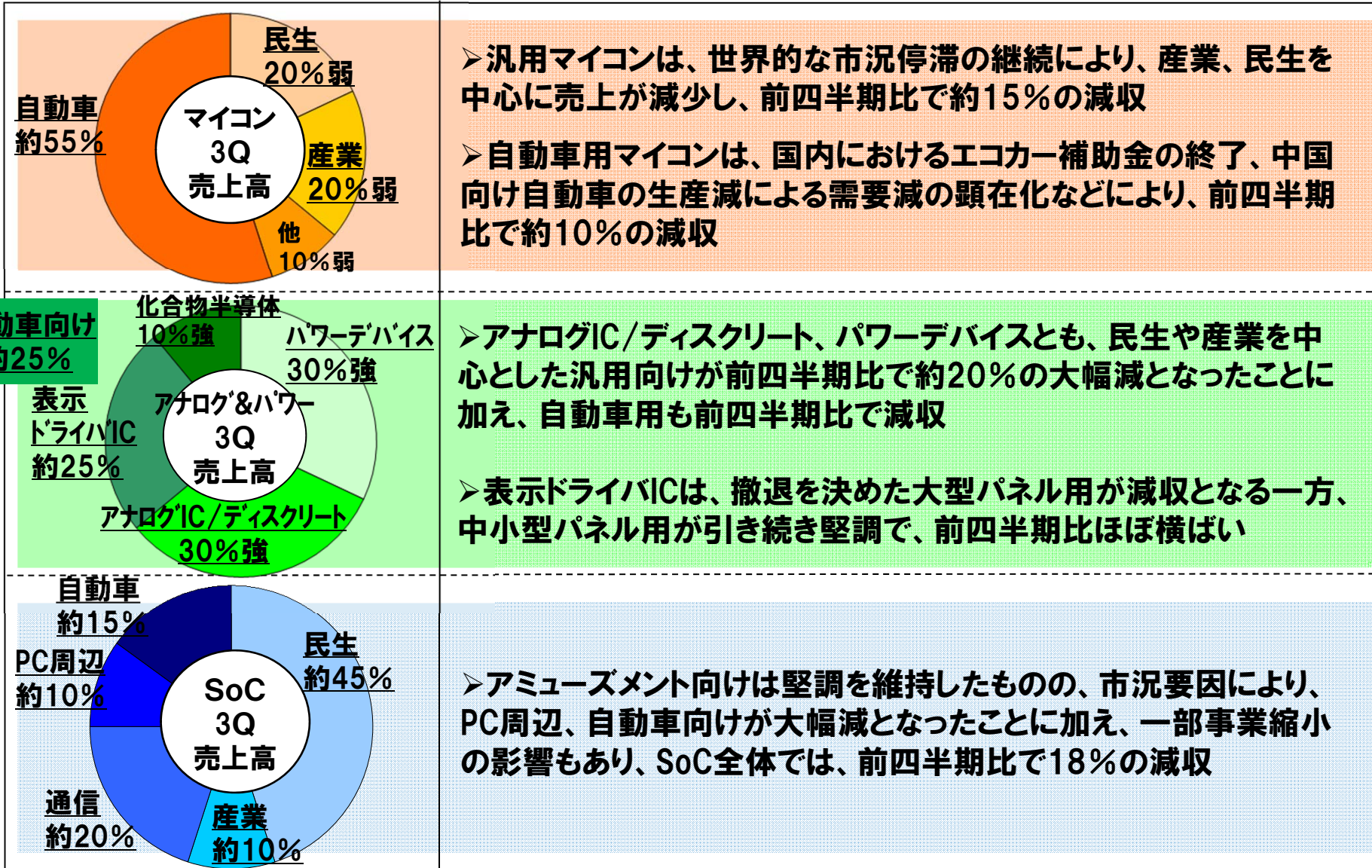


# 2013年3月期 第3四半期 半導体売上高の事業別状況①

- 第3四半期の半導体売上高は、3事業とも前四半期比で減少

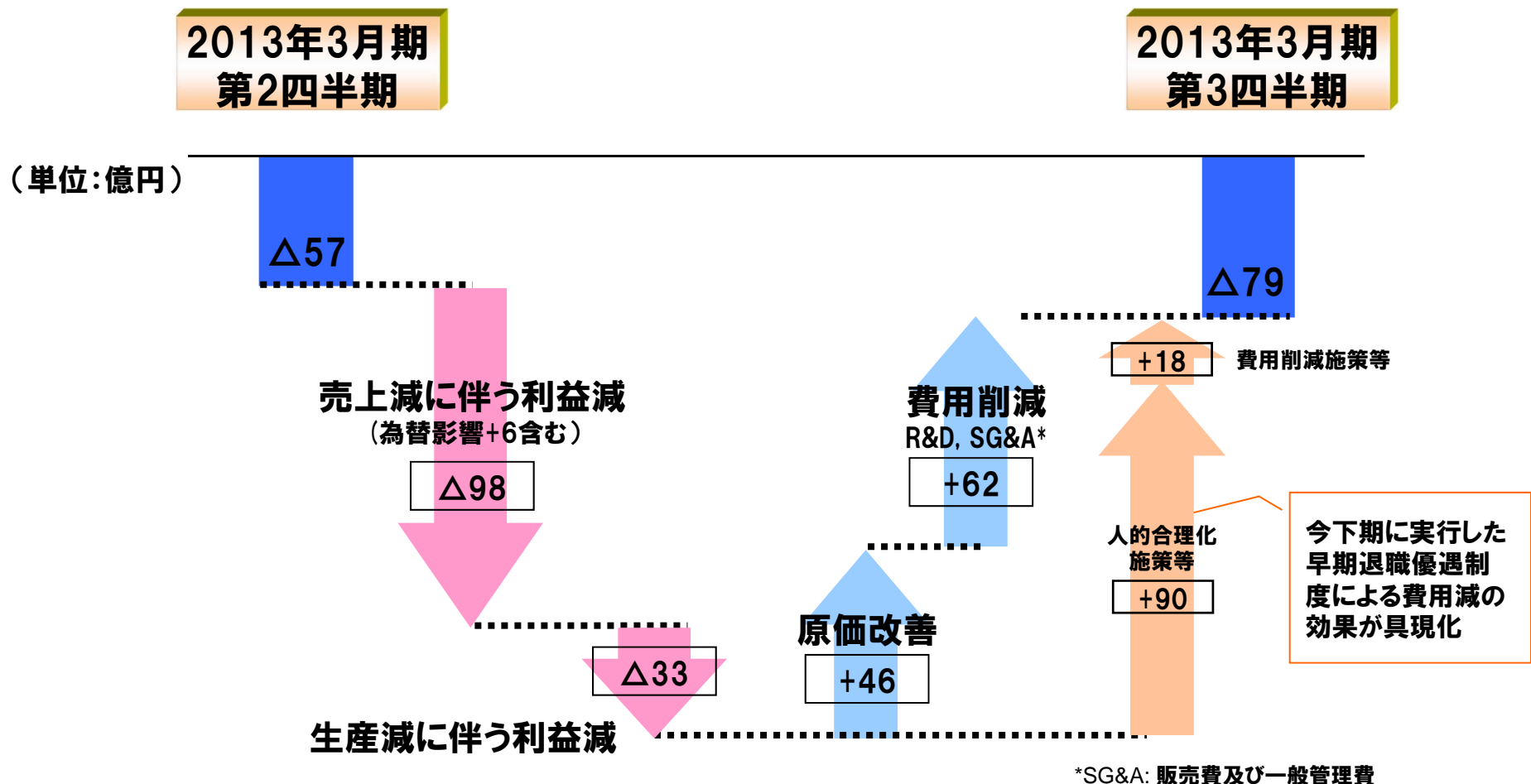
(単位:億円)	2012年3月期	2013年3月期			
	第3四半期	第2四半期	第3四半期	前四半期比	前年同期比
半導体売上高 計	1,980	2,053	1,772	△281 (△14%)	△208 (△11%)
マイコン	886	809	712	△98 (△12%)	△175 (△20%)
アナログ&パワー 半導体(A&P)	545	681	578	△103 (△15%)	+33 (+6%)
SoC	534	550	451	△99 (△18%)	△83 (△16%)
その他半導体	14	13	31	+17	+17

## 2013年3月期 第3四半期 半導体売上高の事業別状況②



# 2013年3月期 第3四半期 営業損益（前四半期比）

- 営業損益は、構造対策による固定費削減効果が出てきているものの、売上減に伴う利益減により、前四半期比で22億円の悪化



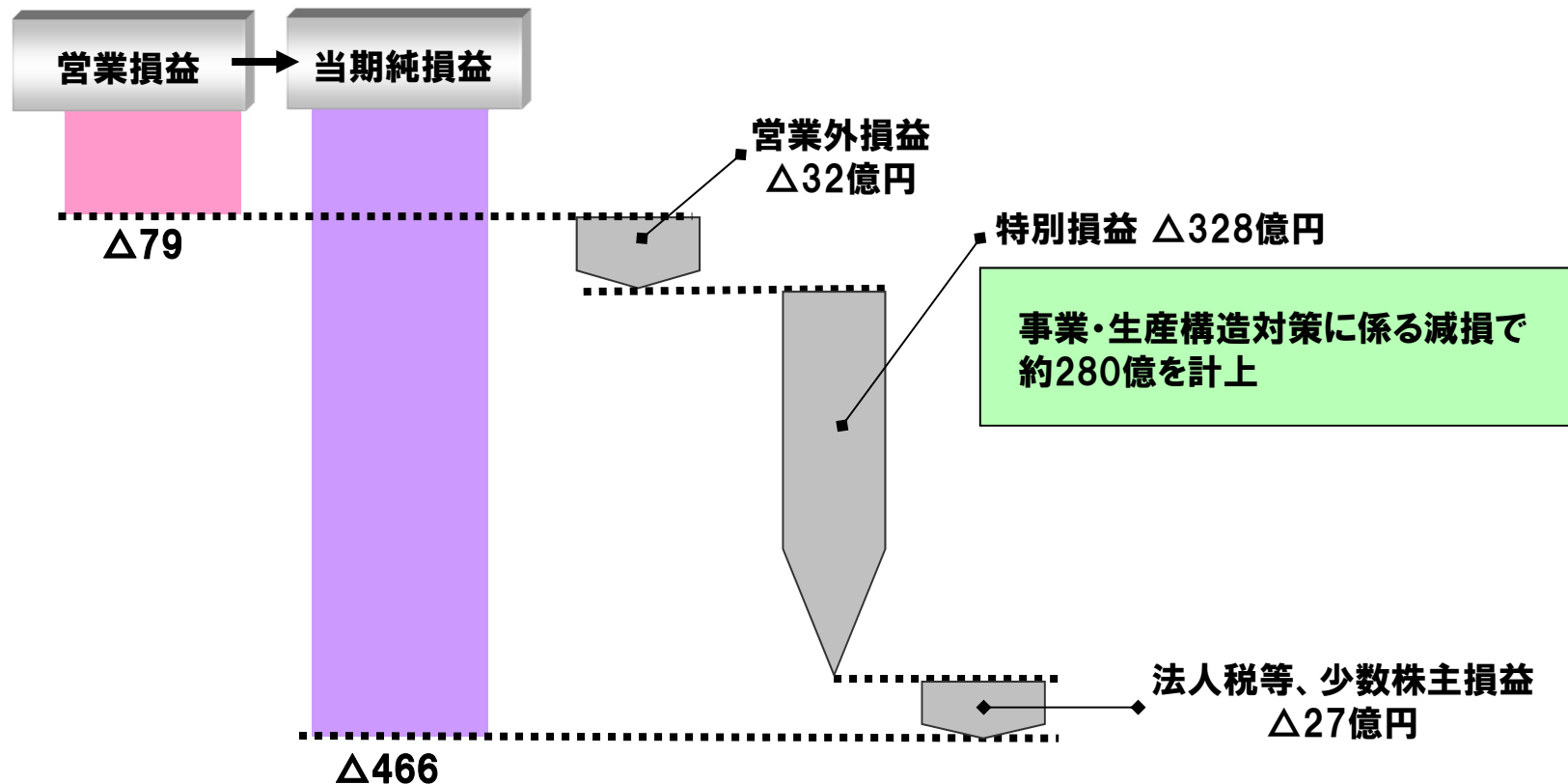


# 2013年3月期 第3四半期 当期純損益

- 事業・生産構造対策などにより、328億円の特別損益を計上し、当期純損益は466億円の赤字

2013年3月期 第3四半期

(単位:億円)



# バランスシート状況

(単位:億円)	12/3末	12/9末	12/12末
<b>総資産</b>	8,582	7,483	7,167
<b>うち 現金及び現金同等物</b>	1,319	696	951
<b>うち たな卸資産</b>	1,518	1,479	1,493
<b>負債合計</b>	6,317	6,414	6,433
<b>うち 有利子負債</b>	2,583	2,393	3,162
<b>株主資本</b>	2,434	1,283	817
<b>純資産合計</b>	2,265	1,068	734
<b>D/Eレシオ(グロス)</b>	1.19倍	2.46倍	5.00倍
<b>D/Eレシオ(ネット)</b>	0.58倍	1.74倍	3.50倍
<b>自己資本比率</b>	25.4%	13.0%	8.8%

(注)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。

②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」

③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本

## キャッシュ・フローの状況

- 第3四半期のフリー・キャッシュ・フローは536億円の赤字であったが、早期退職優遇制度の実施に係る一時金支払いの影響を除けば、営業キャッシュ・フローは第2四半期に続き黒字、フリー・キャッシュ・フローも黒字に回復

(単位：億円)	2012年3月期			2013年3月期			
	第3四半期	9ヶ月累計 (4-12月)	通期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	9ヶ月累計 (4-12月)
営業活動による キャッシュ・フロー	180	△31	△97	△181	46	△475	△610
投資活動による キャッシュ・フロー	△152	△477	△551	△107	△98	△61	△265
フリー・ キャッシュ・フロー	29	△508	△648	△287	△52	△536	△875

## II. 2013年3月期 通期業績予想

# 2013年3月期 連結業績予想の修正

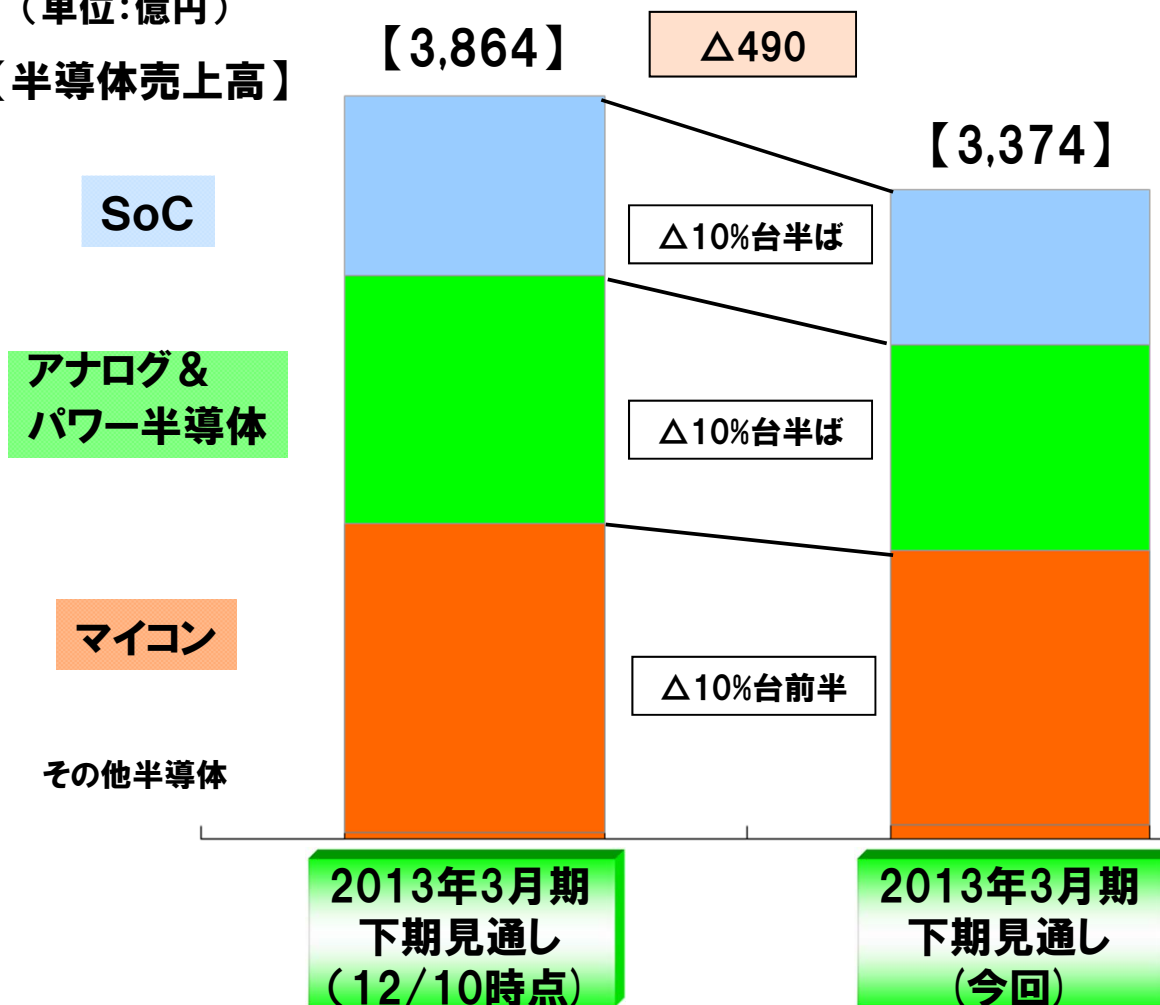
- 下期にかけて一定の市況回復を見込んでいた自動車・産業機器向けや、大型カスタム案件による堅調な売上を見込んでいた民生向けなどが、中国向け自動車・電子機器等の生産減による需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞の影響を受け、売上高を下方修正
- 通期の営業損益は260億円の赤字、当期純損益は1,760億円の赤字へ

(単位:億円)	2012年3月期			2013年3月期				
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期見通し	通期見通し	通期前回予想(*)	前回予想比(前期比)
<b>売上高</b>	4,505	4,326	8,831	4,094	3,606	7,700	8,200	△500 (△1,131)
<b>半導体売上高</b>	4,022	3,838	7,860	3,736	3,374	7,110	7,600	△490 (△750)
<b>営業損益</b>	△292	△276	△568	△233	△27	△260	210	△470 (+308)
<b>経常損益</b>	△333	△278	△612	△244	△96	△340	100	△440 (+272)
<b>当期純損益</b>	△420	△206	△626	△1,151	△609	△1,760	△1,500	△260 (△1,134)
1US\$=	81円	78円	79円	80円	83円	82円	80円	2円 円安
1ユーロ=	115円	104円	109円	102円	109円	106円	103円	3円 円安

\*前回予想は12/10の業績予想修正時

# 2013年3月期 下期半導体売上見通し(前回想定比)

(単位:億円)  
【半導体売上高】



## <主な減収要因>

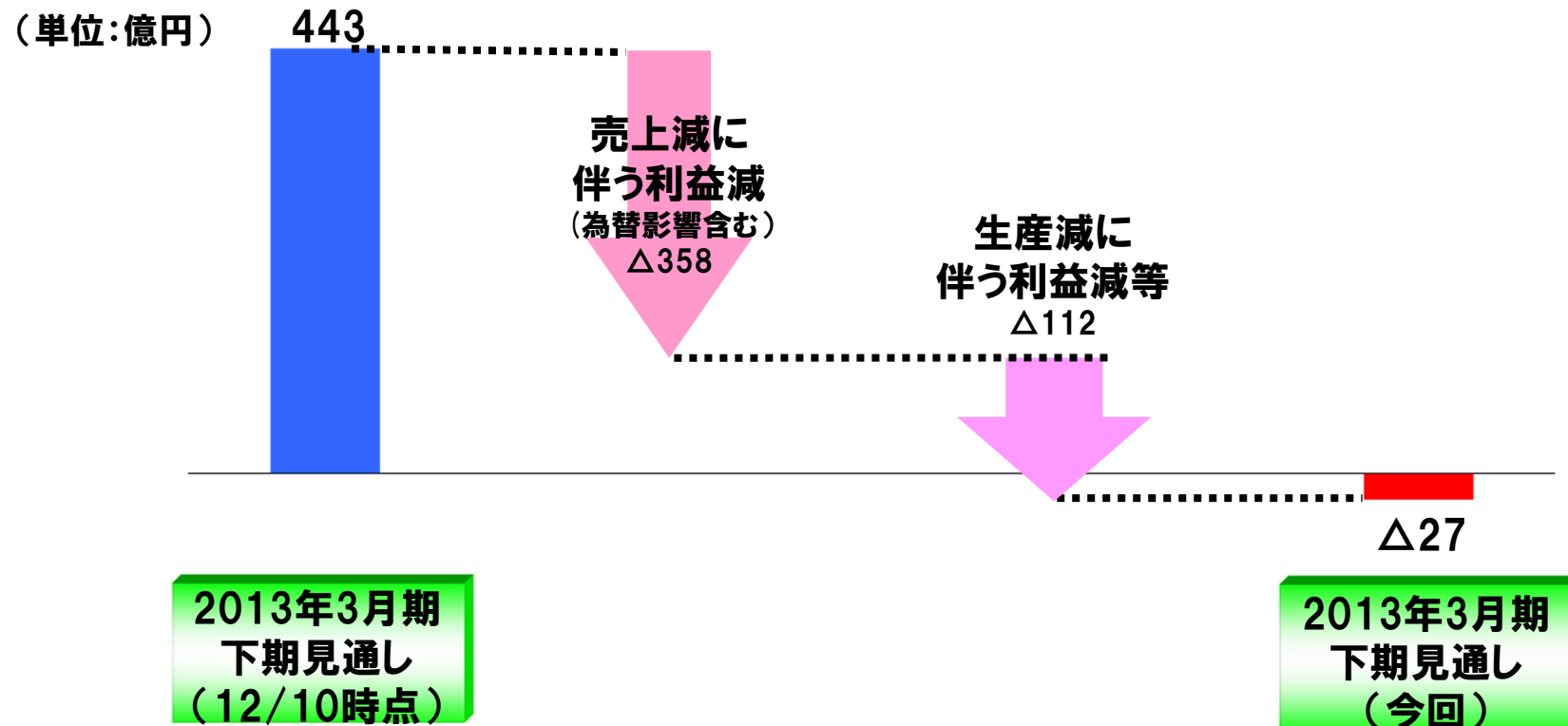
### 【市況要因】

- ①世界的な市況停滞の長期化により、下期からの回復を見込んでいた当社予想とのギャップ発生
- ②中国向け電子機器等の生産減に伴う需要減の更なる顕在化

### 【主なアプリケーション別】

- ①自動車向け半導体:約180億円
- ②民生向けカスタム半導体:約100億円
- ③産業・PC周辺等:約110億円

# 2013年3月期 下期営業損益見通し(前回予想比)



### III. 人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況



## 更なる合理化施策の推進

費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進

### 背景

- ✓ 市況の構造変化を受け、売上は減少傾向

### 目的

- ✓ 費用構造の改善による収益基盤の更なる強化
- ✓ 意思決定の迅速化、業務の適正化・効率化
- ✓ 成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築

早期退職優遇制度の実施を労働組合に  
申し入れ(13年1月17日発表)

### 早期退職 優遇制度

- ✓ 対象者 : 当社及び国内連結子会社の40歳以上の総合職等
- ✓ 退職予定日: 2013年9月30日
- ✓ 想定人数 : 3千数百名
- ✓ 効果・費用 : 未定 (現在諸条件について、労使協議中)

## 生産構造対策の進捗

- 2012年7月3日に生産構造対策を公表後、後工程1拠点の譲渡完了に続き新たに後工程3拠点の譲渡を決定し、生産構造対策は計画どおり進捗

	方針	現在の国内 拠点数/ライン数	構造対策後の国内 拠点数/ライン数
前工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 大口径・微細化</li> <li>✓ 先端製品のアウトソース化</li> <li>✓ 特殊製品の自社生産継続</li> </ul>	9拠点 14ライン	7拠点 9ライン
後工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 海外生産シフトの加速</li> <li>✓ 国内外のサブコン活用強化</li> </ul>	8拠点 →5拠点 (13年6月予定)	2拠点

### ■13年1月1日 完了

- ✓ ルネサスハイコンポーネンツ(青森工場)\*1をアオイ電子\*2に譲渡完了

### ■13年1月30日 発表

- ✓ ルネサス北日本セミコンダクタの函館工場\*3、ルネサス関西セミコンダクタの福井工場\*4、ルネサス九州セミコンダクタの熊本工場\*5を13年6月上旬にジェイデバイス\*6に譲渡予定

\*1:株式会社ルネサスハイコンポーネンツ(青森県北津軽郡鶴田町)

\*2:アオイ電子株式会社(香川県高松市)

\*3:株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 函館工場(北海道七飯町)

\*4:ルネサス関西セミコンダクタ株式会社 福井工場(福井県坂井市)

\*5:株式会社ルネサス九州セミコンダクタ 熊本工場(熊本県大津町)

\*6:株式会社ジェイデバイス(大分県臼杵市)

# 機動的かつ強靱な費用構造への変革を推進

- これまで発表し、実行している人的合理化施策、事業・生産構造対策の完遂により、大幅な固定費の削減を実現し、収益構造を変革

## 人的合理化

事業・生産構造対策に加え、管理職を始めとする間接人員のスリム化により、13年度の人件費を12年度比で約15%削減、統合初年度の10年度比では約40%削減。

## 生産体制再編

工場の譲渡、集約、規模の適正化などにより、13年度の減価償却費・リース費を12年度比で約25%削減、統合初年度の10年度比では約35%削減。

# 足元での改革を推進し、新たな成長に向けた施策を実行

## 迅速な収益構造改革

- 費用構造
- 製品ポートフォリオ

## 第4四半期が売上の底となる見込み

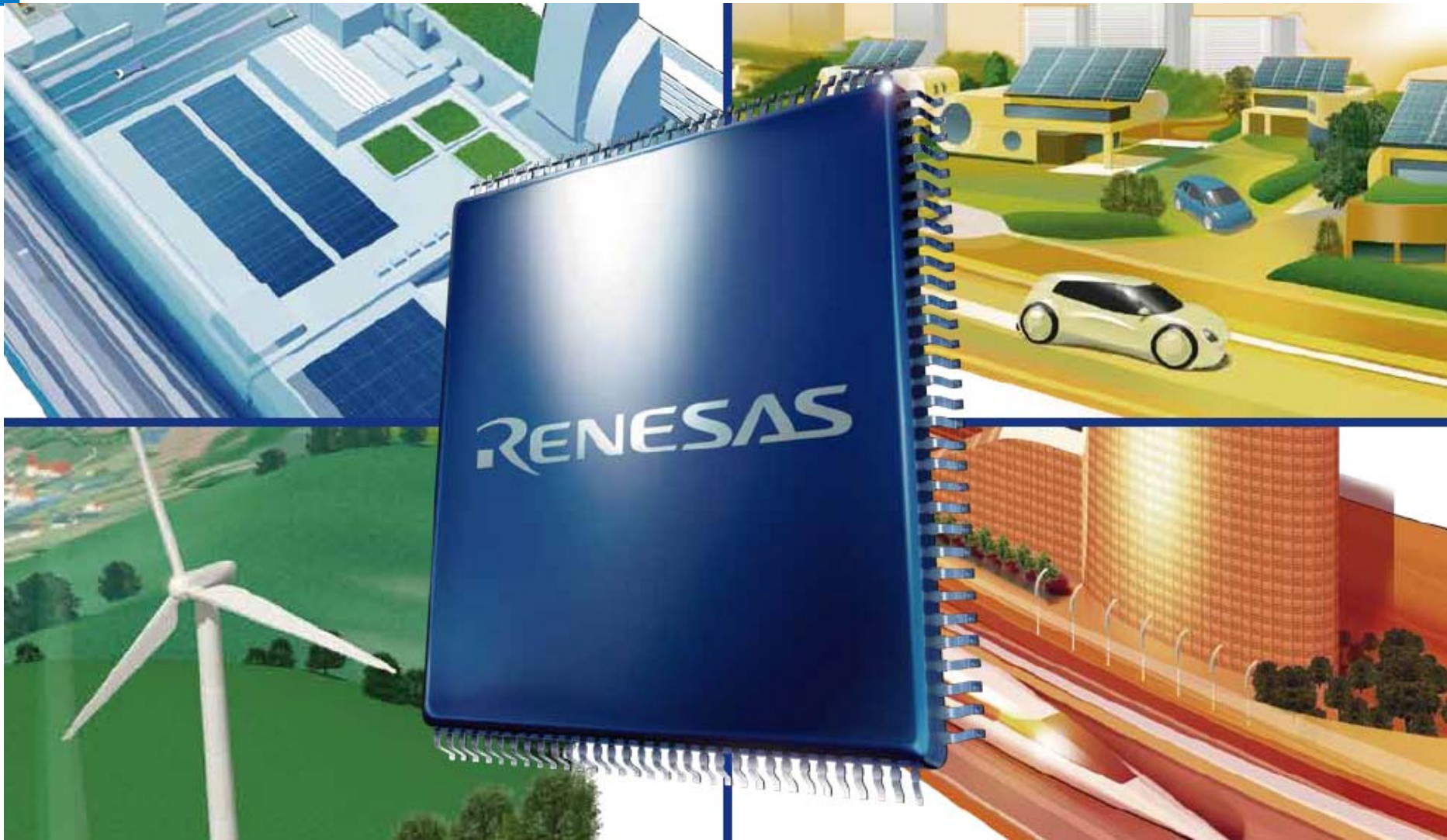
- 第1四半期から緩やかに回復

## 安定した財務体質 + 成長への戦略投資

- 1,500億円の資本増強

## まとめ

- 2013年3月期 第3四半期の半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円、営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、79億円の赤字
- 通期の業績予想については、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の更なる顕在化や長引く世界経済の停滞などの影響を受け、売上高、損益とも下方修正
- 費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進
- 新たな成長に向けた資本増強計画を控え、足元での構造改革を推進中



**(将来予測に関する注意)**

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

The logo for Renesas Electronics Corporation, featuring the word "RENESAS" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "R" is stylized with a curved underline.

**ルネサス エレクトロニクス株式会社**

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.